1. Record Nr. UNINA9910288453003321

Autore	Metge, Bernat <ca.1346-ca.1413>
Titolo	Book of fortune and prudence / Bernat Metge ; introduced and translated by David Barnett
Pubbl/distr/stampa	Barcelone : Tamesis, 2011
ISBN	978-1-855662-28-5
Descrizione fisica	87 p. ; 24 cm
Collana	Colección Támesis . Serie B , Textos ; 55
Disciplina	849.932
Locazione	FLFBC
Collocazione	849.932 MET 2
Lingua di pubblicazione	Catalano
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia

2. Record Nr. UNINA9910471755603321

Titolo	Encyclopedia of packaging materials, processes, and mechanics / editors-in-chief, Avram Bar-Cohen, Jeffrey C. Suhling,, Andrew A. O. Tay
Pubbl/distr/stampa	Hackensack, New Jersey : , : World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., , [2020]
ISBN	9789811201110 9789811201127 9789811201134 9789811201141 9789811201158
Descrizione fisica	4 volumes : ill. ; 25 cm
Disciplina	688.8
Locazione	FINBC
Collocazione	13 SC V L 19 13 SC V L 20 13 SC V L 21 13 SC V L 22
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Nota di bibliografia	Includes bibliographical references and index.
Nota di contenuto	volume 1. Flip-chip and underfill materials and technology / editors, Pengli Zhu, Gang Li, C. P. Wong volume 2. Wire bonding technology / editors, Dae Young Jung, Stephen R. Cain, William (Bill) T. Chen, Bahgat G. Sammakia volume 3. Flexible chip I/O interconnects / editors, Muhannad S. Bakir, Suresh K. Sitaramanof volume 4. Wafer bonding technology / Kuan-Neng Chen, Chuan Seng Tan